第6期 株主通信

2010年4月1日～2011年3月31日

Tera Probe

Mothers
証券コード:6627

経営理念

常に、チャレンジ精神と誇りをもってビジネスに取り組み、技術を磨き、生産の効率化を進め、世界中のお客様が心から満足し信頼できるパートナーとして、新たな価値創造に貢献します。

Contents

株主のみなさまへ……1
越丸新会長、渡辺新社長インタビュー …3
ビジネスモデルについて ……7
半導体製造工程と当社事業の役割
ビジネスモデルについて ……9
テストハウスビジネスの特徴
成長戦略……10
トピックス ……11
事業拠点……12
要約連結財務情報……13
業績ハイライト ……14
会社情報……裏表紙

グローバル展開で成長してまいります。

事業のご報告に先立ち、この度の東日本大震災により被災された皆様方には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復興の日を迎えられますことをお祈り申し上げます。

代表取締役会長
越丸　茂
（前代表取締役社長兼CEO）

株主のみなさまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り心より厚く御礼申し上げます。

前期を振り返って

当社は昨年12月16日にお蔭様をもちまして東証マザーズに上場いたしました。株主のみなさまには上場以来ご支援を賜り、誠に有難うございます。

さて、当社グループが属する半導体市場は、スマートフォンなどのモバイル製品向け需要が市場を牽引し、堅調に推移しております。その結果、当社の2011年3月期は売上高が前年度比20%増の214億円、営業利益は同79%増の52億円と増収増益となりました。事業別の売上は、メモリが19%増、システムLSIは32%増でした。特にメモリ事業は受託量がもともと大きいこともあり、19%のアップというのは金額的にも大きな成長につながりました。

今期の予想について

今期2012年3月期の業績予想は売上で255億円（前年度比19%増）、営業利益で57.7億円（同10%増）と過去最高の見通しです。

今後の取り組みについて

今期の重点取り組みについては、以下の3点を考えています。1点目は最大顧客であるエルピーダメモリ対応をきちんとすること。エルピーダメモリのプロセスも微細化し、ウエハ1枚から取れる半導体チップ数が増えており、ウエハテストも対応を迫られています。300ミリウエハ上にDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）という半導体チップが1000個以上作られますが、1回に測定できるチップの数を大幅に増やす技術（多数個同時測定）を開発し、これに対応できるようにしました。これによりスループット（単位時間当たりの処理能力）を大幅に上げることができます。

また、エルピーダメモリが取り組んでいる、貫通電極でチップ間を接続する技術であるTSV（スルー・シリコン・ビア）に対応したテストも、今年度の上期中に技術を確立します。TSVを使った製品の量産時期はお客様の都合もあり、まだ明確になっていませんが、DRAMに限らずシステムLSI事業の分野でも薄型パッケージにいろいろなチップを入れる場合にTSVにも使えそうです。そのTSVに対するテスト技術を持つことができれば、当社の技術優位性がひとつ加わります。これにまず取り組んでまいります。

2点目がシステムLSI事業の単月黒字化です。前年度は32%の増収でしたが、残念ながら黒字化にはいたりませんでした。当社は技術を中心に事業を展開しているので、技術者の数が多く、そのオーバーヘッドをカバーするためには、もう少しテストの受託量を増やさないといけません。上期で単月黒字化を達成し、それを維持して通期で黒字化したいと思っています。

3点目は海外展開です。大量のテスト受託量が見込めるロジックSoC（システム・オン・チップ）ですが、それには、海外のファブレスメーカーを獲得していかないと拡大できません。そのために、当社のマネジメントの下でウエハテスト、パッケージング、ファイナルテストを専門業者がおのおの担当し、シームレスにサービスを提供するターンキービジネスでお客様を取り込んで行きます。われわれが今まで手掛けてきたのはテストだけでしたが、テストから組み立てまで行うサービスをしようというものです。特に、ターンキーサービスによってこれからは海外のファブレスメーカーのビジネス獲得に向けて積極的に動いていきます。

このほかにもうひとつ、中国、韓国で手掛けたいビジネスがあります。それは、現地に自社工場を作り、顧客の近くで仕事をすることです。中国では上海でテスト、あるいはターンキーを展開したいと考えており、また韓国でも同様で、早期にビジネスモデルを構築し、本格的にビジネスをスタートさせたいと思っています。

代表取締役会長
越丸　茂

代表取締役社長兼CEO
渡辺　雄一郎

TOP Interview
トップインタビュー

越丸新会長と渡辺　新社長に抱負を語っていた　だきました。

代表取締役会長　越丸　茂

1976年4月、日本電気㈱に入社。1993年7月より同社LSI事業本部、メモリ事業本部の事業部設計部長等を歴任。海外赴任を経て、2003年7月エルピーダメモリ㈱。同社CMO等を歴任した後、2007年5月から4年にわたり、当社代表取締役社長兼CEOを務める。
2011年6月、当社代表取締役会長に就任。

代表取締役社長兼CEO　渡辺　雄一郎

1992年4月、日本電気㈱に入社。2004年10月エルピーダメモリ㈱。F&A Office エグゼクティブマネージャー等を歴任。2010年6月より当社取締役。TeraPower Technology Inc.の取締役兼任。
2011年6月、当社代表取締役社長兼CEOに就任。

Q 今回の人事の目的と新しい取り組みはありますか。

越丸　創業6年目を迎え、マザーズ上場も果たした現在、経営基盤を一層強化する必要があり、代表取締役を2名体制としました。私がグループ全体を見て、渡辺社長がテラプローブ事業体制のさらなる強化に当たっていきます。お蔭様をもちまして、前年度は良い実績を出せ、今年度も過去最高の業績を予想しており、これまで支えていただいた株主のみなさまには配当として報えると考えております。

渡辺　基本的な経営戦略は、これまでと大きく変えるつもりはありません。どのようなアクションをすれば良い結果に繋がるのか、ということを考え実行していきます。その具体的な取り組みとして、日本にはテストハウスであるテラプローブという会社があるということを世界のお客様にまず知っていただき、これまで当社が日本の半導体産業の中で培ってきた技術、ノウハウをいろいろなファブレスメーカーやデザインハウスに提供できる機会を増やしていきます。

Q 今後は、東証一部へ市場変更をするお考えはありますか。

渡辺　東証一部上場とマザーズ上場の会社とでは、マーケットにおける信用度は確実に違うと思っています。事業を拡大させる、会社を発展させる、あるいは投資家の方々に会社のことを広く知っていただくためには、東証一部への市場変更は必要だと思っています。ただ、東証一部上場が最終目標ではなく、会社として業績を上げて利益を出していくことが、経営陣の最大の目的だと思っています。そのための手段として、市場変更を検討していきたいと考えています。

越丸　マザーズ上場により、44億円の調達ができましたが、今後の設備投資、M&Aなど会社の成長のための資金需要を考えると、マザーズから一部への市場変更は検討したいと思っています。実際にＩＰＯ直後からM&Aの案件が持ち込まれており、中には先日公表された通り、既に動き始めたものもあります。今後も会社の成長を目的としたM&Aへの資金調達を考えると、一部への市場変更も含めて検討すべきですね。

Q 中長期的成長戦略をお聞かせください。

越丸 今後の経営方針についてですが、日本にはテラプローブがあり、台湾には子会社のTeraPower Technology Inc.(以下、テラパワー)がありますが、これまでは、日本のお客様、台湾のお客様に対して、個々に対応する傾向があったように思います。これからはワールドワイドのお客様に対して、テラプローブ、テラパワーが連携し様々な要求に応じてサポートしてゆく体制で成長を遂げていきます。

渡辺 具体的には、「技術の流出などが不安」というお客様には日本でサービスし、それよりも「コスト勝負でいきたい」というお客様には台湾でサービスするといった選択肢のある形で、お客様にソリューションを提供していきたいと考えています。また成長のための設備投資についてはロジックテストビジネスを中心に進めていきたいと思っています。同時に、必要であればM&Aや他社とのアライアンスを組むために資金配分をしていきたい。

今後の事業展開についてですが、メモリテストビジネスでは、現在エルピーダメモリとパートナーとしての強固な関係を築いており、今後もエルピーダメモリビジネスに最大限に貢献していきます。また、メモリテストビジネスで培った技術やノウハウを武器に、国内外の半導体メーカー、デザインハウスなどにも積極的にアプローチしていきます。世界中には我々の知らないポテンシャルカスタマーがたくさん居ると思うので、当社の技術力を発揮できる場はまだまだたくさんあると思います。

ロジックテストビジネスでは残念ながらまだ赤字の状況ですから、まずは黒字化が至上命題です。ここはなんとしても早期の黒字化を実現する。その後の展開についてですが、ロジックテストビジネスは基本的には、お客様のサイトの近くでテスト事業を行うことが最も効率的だと考えています。たとえば、お客様が中国にいるということなら、中国に拠点を作ってそこでテストビジネスを行う。今、台湾でテラパワーがやっているようなビジネスモデルです。ロジック半導体製品はその用途、製品が多岐にわたっているためお客様のニーズも様々です。我々はそのニーズを捉えて、最適なソリューションを提供していきたいと考えています。

―― なるほど半導体の会社は拡散工場でつくったウエハをテストしますが、テストの結果を拡散工場の方にフィードバックしないと歩留まりが上がらない。だから、テストサイトは拡散工場の横にあるのが一番いいということですね。

渡辺 半導体の世界では、中国の力が今後は非常に強くなってくると思います。コストの安さだけではなく、国としても半導体事業を強化している。その中で、世界中のデザインハウス(半導体企業から回路設計の全体、又は一部分の設計作業のみを請け負う外部企業)は中国のファンダリ(半導体製造のみを専門に受託するビジネス)会社へ生産委託するという流れはますます加速していくでしょう。つまり世界中の半導体生産が中国へ集中することになります。現在の中国のファンダリ会社の多くは、それほど大規模なテストラインをもっていないし、そもそも中国にはテストハウスという会社が現在存在していないため、生産を委託する側が出来上がったウエハを持ちかえって自分たちでテストをする、というのが主流となっています。しかしファンダリ会社にテスト拠点があれば持ち帰らなくてすむため、物流コストが削減できます。さらにその後の組立工程まで含めて当社が中国国内でサービスを提供できれば、工期の短縮やコスト削減が可能となります。

当社が展開するターンキービジネスでは、組立工程について有望なアセンブリハウスとパートナーシップを構築しており、当社のマネジメントの下でお客様であるデザインハウスの要求に応えていく、そのようなビジネスモデルがますます増えてくると当社の中長期的な成長が予想できます。

Q 株主還元についてと株主のみなさまにメッセージを下さい。

越丸 株主還元に関しては、業績を計画通り達成できれば、今期に１株当たり35円の配当で還元することを決算短信にも書いています。内部留保の使途としては引き続き成長分野に投下していくことを優先して考えています。

渡辺 とにかくテラプローブは若い会社なので、勢いだけはなくさないでやっていきたい。今回、トップも会長には失礼ですが、かなり若返りました。これは、これからも勢いを持って市場を切り開いていくというメッセージと受け取っていただき、成長し続ける会社として認知していただけるような業績を上げていきたいと思っていますので、今後ともご支援を賜りますようお願い致します。

半導体製造工程と当社事業の役割

テストハウスとは

世界の半導体業界ではテストや組立工程などを自社で行わず専門の会社が行う水平分業が主流になりつつあります。工程におけるテスト部分を専門に受託する専門業者のことをテストハウスといいます。下のチャートはメモリを例とした半導体製造の工程です。テストハウスとしての当社の技術が、半導体製造工程には欠かせません。

前工程　後工程

設計工程

1 理論回路設計
必要な機能をどのような電子回路で実行するかを決定。

2 レイアウト設計
実際の配線パターンを設計し、マスク用図面を作成。

3 テストプログラム開発
設計通り機能するか確認するためのプログラム開発。

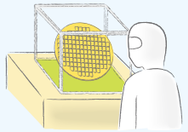
ウエハ製造工程

4 ウエハ調達
高純度なシリコンを円盤状に切断研磨して作成されたウエハを調達。

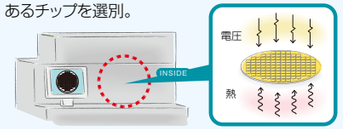
5 回路作成
成膜、露光、現象、エッチングを何回も繰り返し、半導体回路を作成。

ウエハテスト工程

6 外観検査
目視等で外観の異常の有無をチェック。

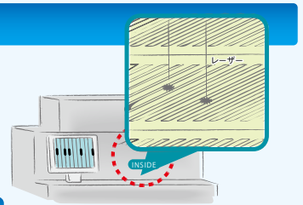


7 ウエハレベルバーンイン
高温、高電圧などのストレスをかけて異常の有無をチェック。潜在的に初期不良となるおそれのあるチップを選別。



8 予備テスト
冗長回路を含むすべての回路の動作状況をテストし、不良部分を冗長回路で救済可能か判断。テスト結果は自動的にサーバーに送信。

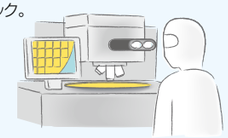
9 トリミング
8のテストで不良部分を正常に動作する冗長回路に切り替えるためのレーザー加工。



10 本テスト
予備テストと同じ作業を再度行い、全てのチップをテストして、良品か不良品かを判別。

11 検査データフィードバック
検査結果を自動的にサーバーに送信。サーバーに蓄積したデータを顧客に送信。

12 出荷外観検査
表面・裏面の汚れ・異常とプローブ跡をチェック。



アセンブリ工程

13 パッケージング
ウエハをチップサイズに切断し、製品として組み上げる。

ファイナルテスト工程

14 特性選別
製品として設計通り機能するかをチェック。

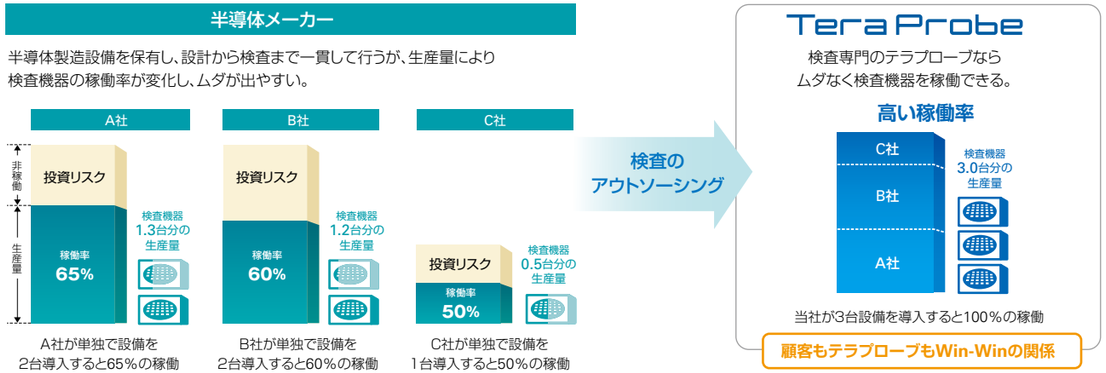
15 バーンイン検査
高温・高電圧などのストレスをかけて異常の有無をチェック。

※システムLSI事業においては、ファイナルテストも当社で行っています。

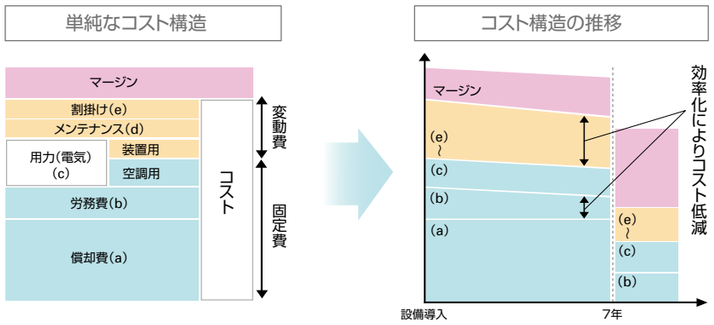
■ ……当社が受託する工程

テストハウスビジネスの特徴

半導体企業がウエハテストを外部に委託すると、テスト機器への設備投資が不要になり、それ以外の工程に資源を集中することができます。当社は複数の半導体メーカーからテストを受託することでテスト機器の高い稼働率を維持し、顧客の低コスト化に寄与しています。この結果、信頼性が高く安価な半導体が多くの製品に使用されています。



テスト単価の決まり方



テストハウスは装置産業の特徴として、コストに占める減価償却費の割合が高くなっていますが、導入した最先端設備は、償却期間後も長期にわたって活用することが可能です。

$$(a)=\frac{\text{テスタ+プローバ等の購入費用}}{\text{償却期間}\times 12\text{ヶ月}\times 30\text{日}\times 24\text{時間}}$$

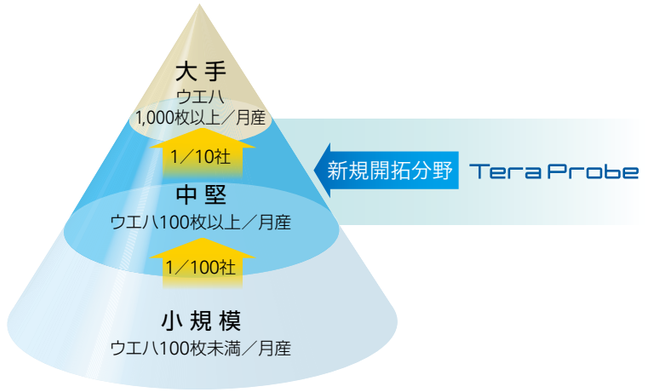
$$(b)=\frac{\text{人数}\times\text{給与}}{30\text{日}\times 12\text{時間}}$$

※24時間／2交代制

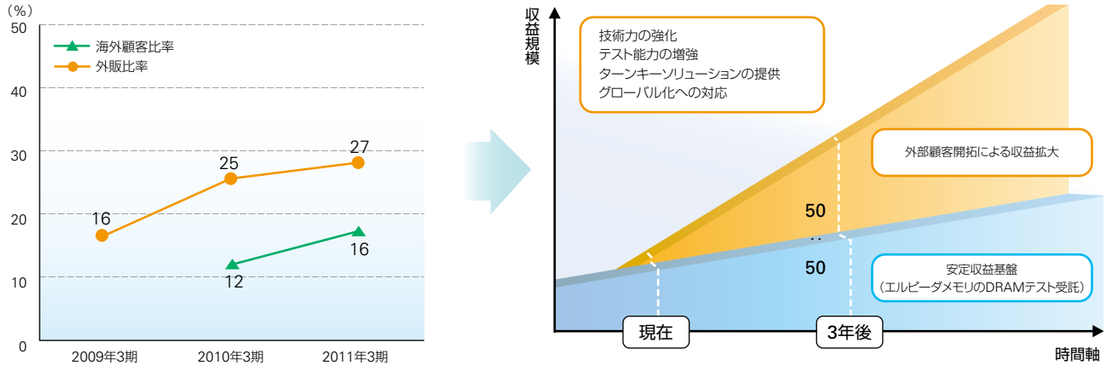
コストを基にテスト単価が決まるため、製品の市場価格とは連動しません。

重点顧客層

今後の新規顧客開拓は、海外中堅ファブレスメーカーやデザインハウスを中心とした展開を致します。特にこのターゲット層は、将来的に大きく成長をする可能性を持つ有望な層です。当社の強みをバックグラウンドに、顧客が、大手へと成長する一助を担うことで、業績の成長を図ります。



海外顧客･外部顧客の売上比率推移

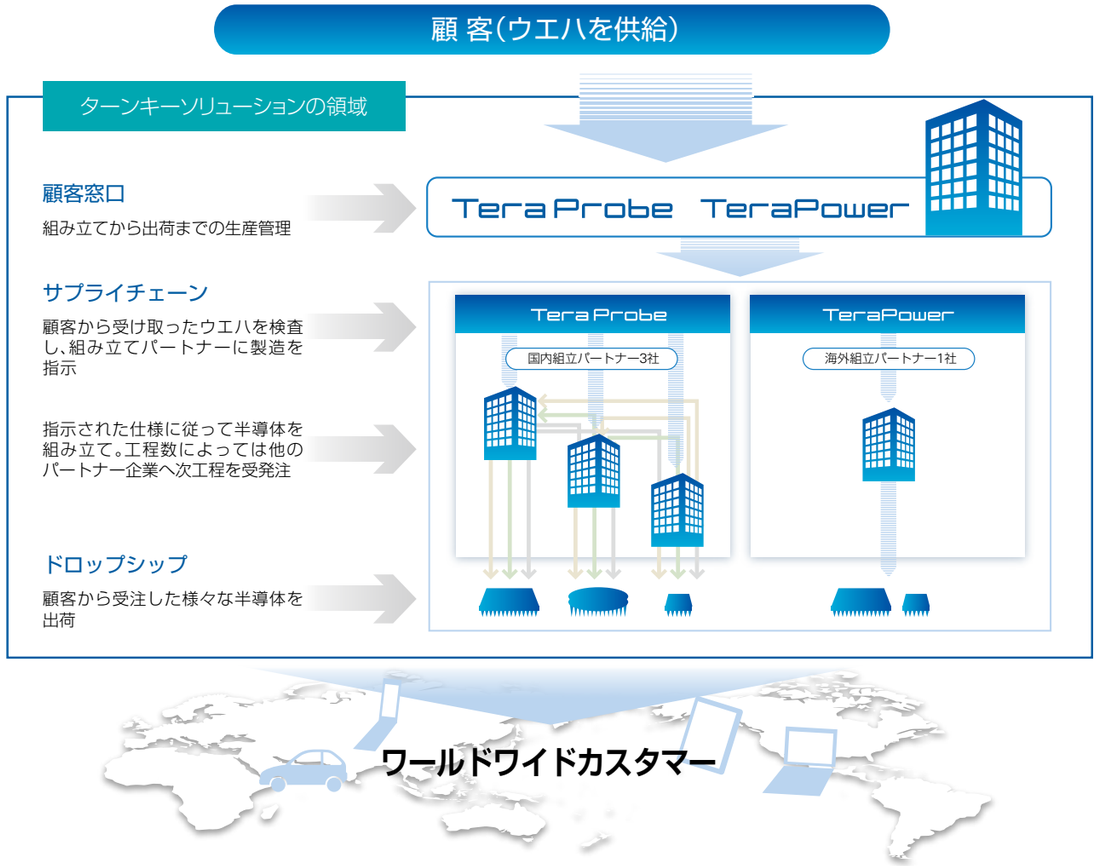


現在、当社の売上比率のおよそ70%をエルピーダメモリ株式会社(以下、エルピーダメモリ)が占めていますが、当社がこれまで培ってきた、技術力、高効率、財務体質の強さをベースに顧客数を増やすことで、3年後にはエルピーダメモリの比率が50%となることを目指し、安定収益基盤を固めながらさらに新規顧客の獲得に努めます。

Topics

トピックス

国内では、メーカーが設計から製造、パッケージングまで全工程を自社内で行う場合が多いですが、海外では各工程に特化した専門業者がそれぞれの工程を担当し、半導体を製造しています。これを水平分業といいます。当社は、ターンキーソリューションを顧客に提供することで、水平分業を推進します。ターンキーソリューションとは、ウエハテスト、パッケージング、ファイナルテストを当社のマネジメントの下、提携する専門業者が担当し、顧客へシームレスにサービスを提供することをいいます。



Business Location

事業拠点

本社・開発センターをはじめ、各地に事業所を展開。広島事業所ではDRAMを中心としたメモリ製品のテスト、九州事業所ではSoC、イメージセンサ、アナログ系のテストをメインに行っています。各拠点はそれぞれ半導体の製造拠点に近く、顧客の物流コストの削減にも貢献。さらに、台湾では子会社のテラパワーが事業を展開。世界の半導体製造の中心である台湾で、世界の様々な顧客の要求に対応できる体制を整えています。

[国内拠点]

Tera Probe

本社・開発センター(神奈川県横浜市)

広島事業所(広島県東広島市)

メモリ系のテスト拠点

[海外拠点]

TeraPower

TeraPower Technology Inc.(台湾新竹縣)

九州事業所(熊本県菊北郡)

SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

Financial Statements

要約連結財務情報

連結貸借対照表

（単位：千円）

科目	平成22年3月末（2010年3月31日）	平成23年3月末（2011年3月31日）
〈資産の部〉		
流動資産	**6,096,198**	**14,698,932**
現金及び預金	2,820,690	7,211,189
受取手形及び売掛金	2,804,096	3,774,836
たな卸資産	167,162	176,631
未収入金	145,208	3,293,869
その他	159,039	242,405
固定資産	**26,643,642**	**35,626,402**
有形固定資産	24,504,790	34,256,423
無形固定資産	784,645	490,844
投資その他の資産	1,354,206	879,134
資産合計	**32,739,840**	**50,325,335**
〈負債の部〉		
流動負債	8,962,875	15,516,563
固定負債	6,115,909	8,251,112
負債合計	**15,078,785**	**23,767,675**
〈純資産の部〉		
株主資本	**16,577,607**	**25,175,698**
資本金	9,600,000	11,823,312
資本剰余金	9,156,955	11,380,267
利益剰余金	△2,179,347	1,972,117
その他の包括利益累計額	**△235,446**	**△281,920**
少数株主持分	**1,318,893**	**1,663,881**
純資産合計	**17,661,055**	**26,557,660**
負債純資産合計	**32,739,840**	**50,325,335**

連結損益計算書

（単位：千円）

科目	平成21年度（2009年4月1日～2010年3月31日）	平成22年度（2010年4月1日～2011年3月31日）
売上高	**17,836,950**	**21,381,338**
売上原価	**13,607,972**	**14,532,130**
売上総利益	**4,228,977**	**6,849,207**
販売費及び一般管理費	1,336,264	1,667,226
営業利益	**2,892,713**	**5,181,981**
営業外収益	654,276	68,230
営業外費用	961,605	414,921
経常利益	**2,585,384**	**4,835,290**
特別利益	103,317	246,700
特別損失	136,061	201,876
税金等調整前当期純利益	**2,552,640**	**4,880,113**
法人税等	**114,295**	**339,009**
少数株主利益	**207,061**	**389,639**
当期純利益	**2,231,284**	**4,151,465**

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

科目	平成21年度（2009年4月1日～2010年3月31日）	平成22年度（2010年4月1日～2011年3月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー	**9,327,151**	**10,382,013**
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△807,796**	**△8,503,314**
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△7,469,502**	**2,532,815**
現金及び現金同等物に係る換算差額	**9,162**	**△21,015**
現金及び現金同等物の増減額（△減少）	**1,059,014**	**4,390,498**
現金及び現金同等物の期首残高	**1,761,676**	**2,820,690**
現金及び現金同等物の期末残高	**2,820,690**	**7,211,189**

連結株主資本等変動計算書

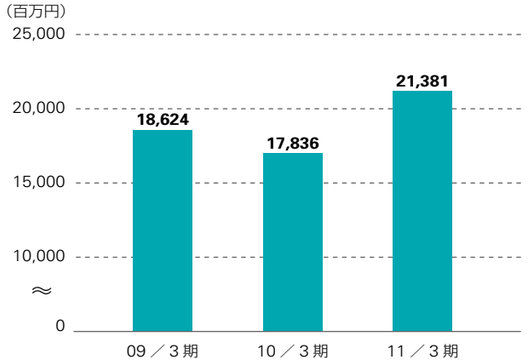
（単位：千円）

科目	平成22年3月末（2010年3月31日）	連結会計年度中の変動額	平成23年3月末（2011年3月31日）
資本金	**9,600,000**	**2,223,312**	**11,823,312**
資本剰余金	**9,156,955**	**2,223,312**	**11,380,267**
利益剰余金	**△2,179,347**	**4,151,465**	**1,972,117**
株主資本合計	**16,577,607**	**8,598,090**	**25,175,698**
その他の包括利益累計額合計	**△235,446**	**△46,473**	**△281,920**
少数株主持分	**1,318,893**	**344,988**	**1,663,881**
純資産合計	**17,661,055**	**8,896,604**	**26,557,660**

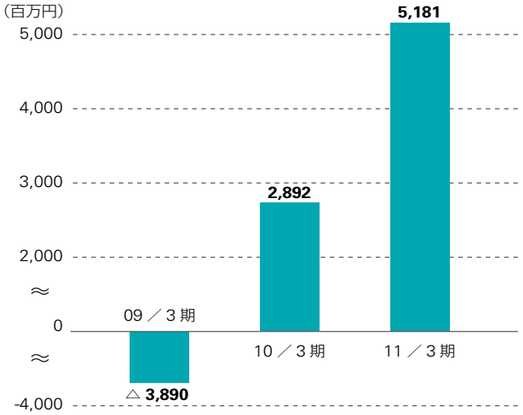
Financial Highlight

業績ハイライト

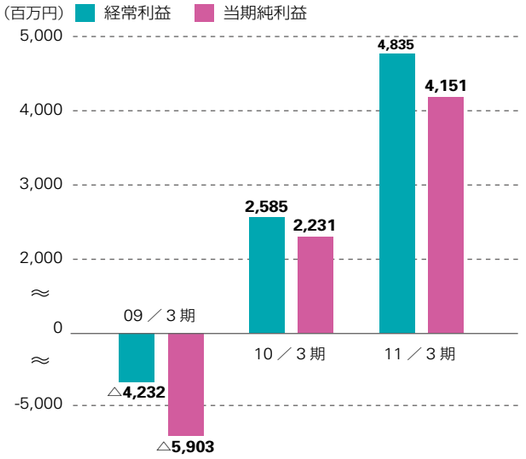
売上高



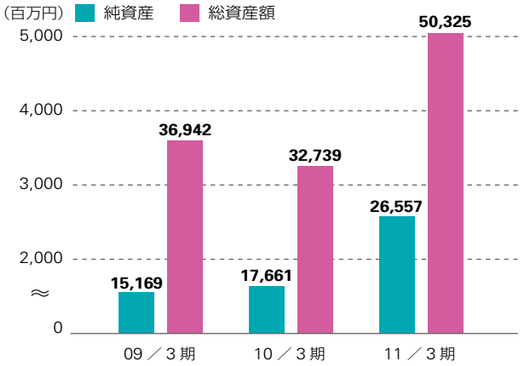
営業利益



経常利益・当期純利益



純資産・総資産額



会社概要 (2011年3月31日現在)

社名	株式会社テラプローブ (英文 : Tera Probe, Inc.)
設立	2005年8月1日
資本金	11,823百万円
従業員	283名(単体)、390名(連結)
事業内容	●メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト及び開発受託) ●システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト及び開発受託)

役員 (2011年6月27日現在)

代表取締役会長	越丸　茂
代表取締役社長兼CEO	渡辺　雄一郎
取締役	小平　広人
取締役	横山　毅
取締役(非常勤)	中川　剛
取締役(非常勤)	髙木　裕
監査役(常勤)	太田　利昌
監査役(非常勤)	栗田　優一
監査役(非常勤)	縣　啓二

株主メモ

上場証券取引所	東京証券取引所マザーズ
証券コード	6627
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎事業年度終了日の翌日から3カ月以内
剰余金の配当の基準日	期末配当金　3月31日
株式の売買単位	100株
公告方法	公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL	http://www.teraprobe.com/
株主名簿管理人	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
同連絡先	東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社　証券代行部 TEL.0120-176-417(フリーダイヤル) URL http://www.sumitomotrust.co.jp/

ホームページのご案内

当社では、株主・投資家の皆様にプレスリリースや決算発表資料などのIR情報をホームページにて公開しております。是非、ご覧ください。

テラプローブ　検索

株式会社テラプローブ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17　TEL:045-476-5711　FAX:045-476-1012
ホームページアドレス **http://www.teraprobe.com/**